



主要特点

内部集成 2: 4 译码器

通道数目: 4

通带频率: 9-9.6 GHz

9.6-10.2 GHz

10.2-10.8 GHz

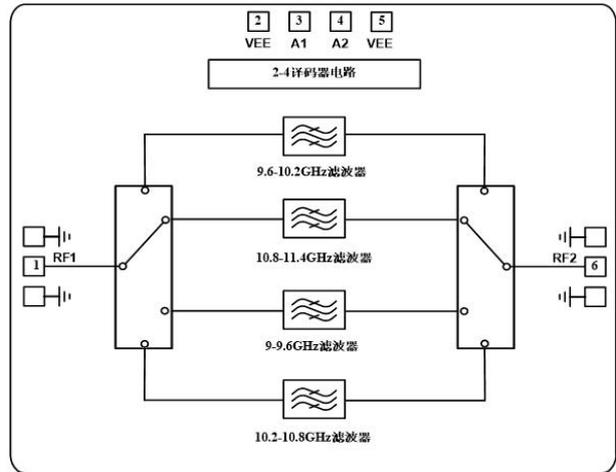
10.8-11.4 GHz

功耗: -5 V @ 6 mA

输入 P-1: 23 dBm

芯片尺寸: 2.5 × 3.0 × 0.1 mm³

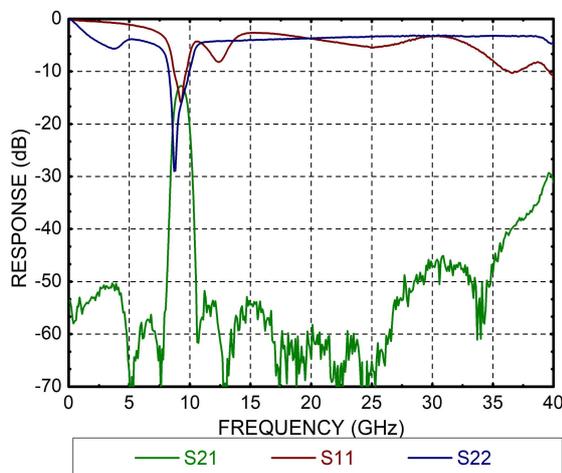
功能框图



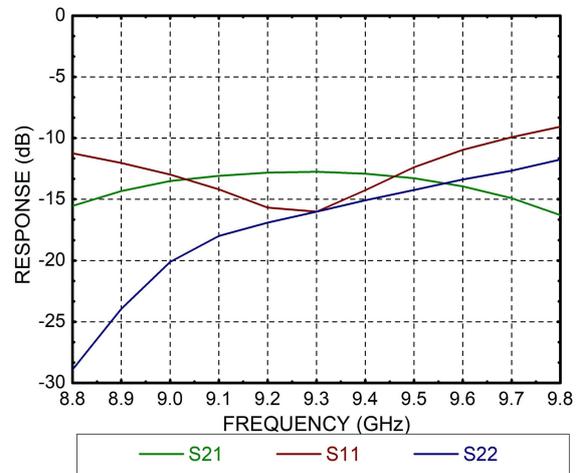
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $VEE = -5\text{V}$)

参数	9-9.6GHz	9.6-10.2GHz	10.2-10.8GHz	10.8-11.4GHz	单位
插入损耗	13	13	13.5	14	dB
带内平坦度	± 1	± 1	± 1	± 1	dB
回波损耗	13	13	15	12	dB
带外抑制	50@8.1GHz 50@10.7GHz	55@8.7GHz 45@11.3GHz	50@9.3GHz 50@11.9GHz	50@9.7GHz 55@12.7GHz	dB

9-9.6GHz反射系数

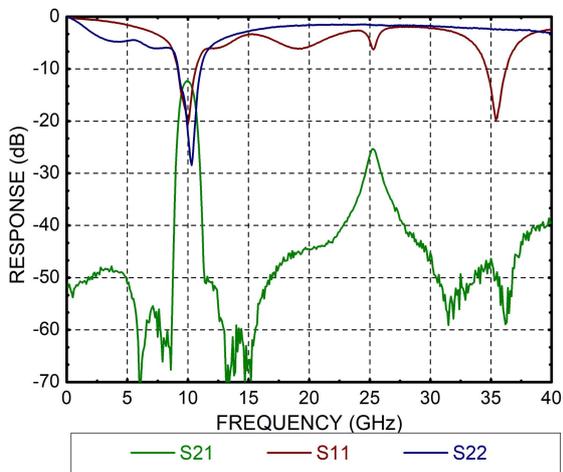


9-9.6GHz反射系数

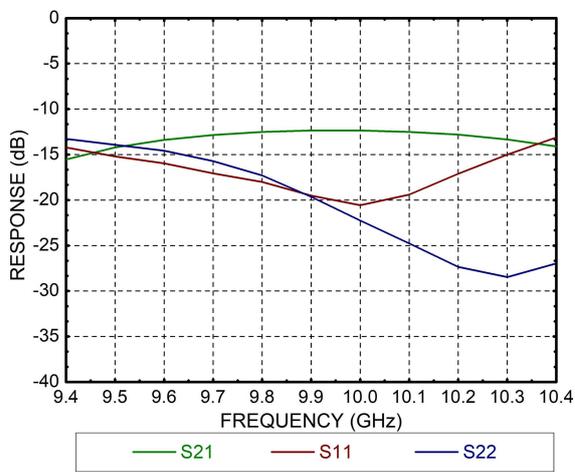




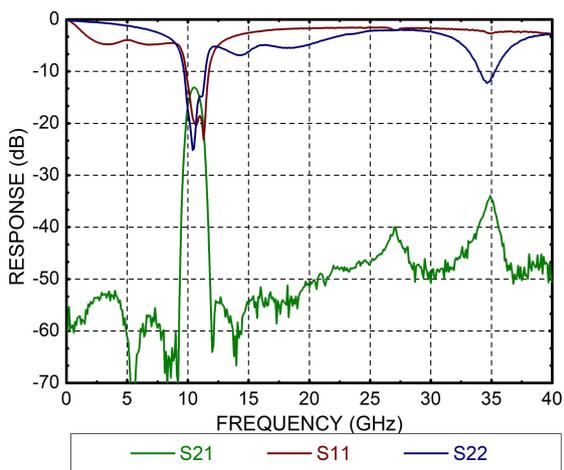
9.6-10.2GHz反射系数



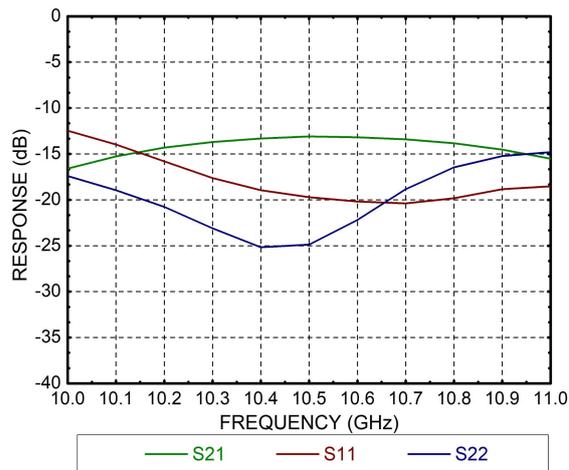
9.6-10.2GHz反射系数



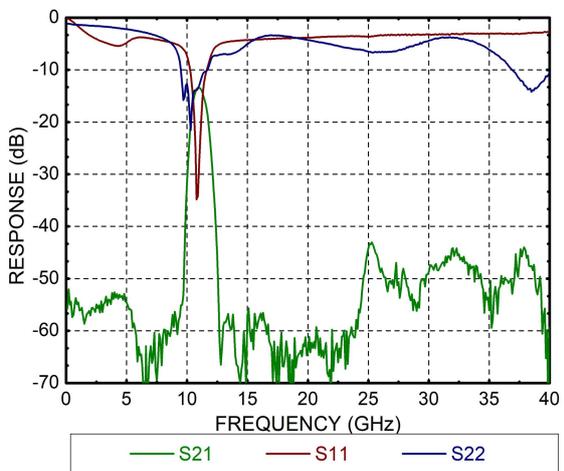
10.2-10.8GHz反射系数



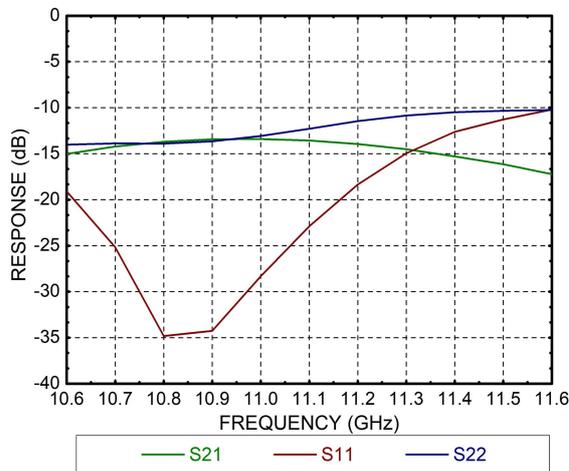
10.2-10.8GHz反射系数



10.8-11.4GHz反射系数

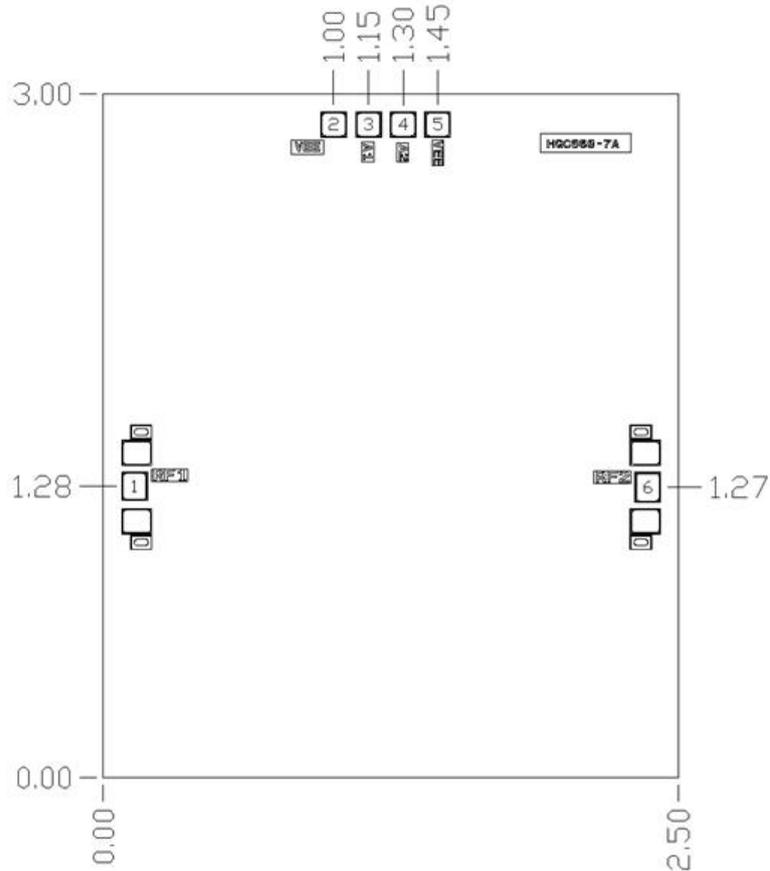


10.8-11.4GHz反射系数





物理参数



焊盘描述

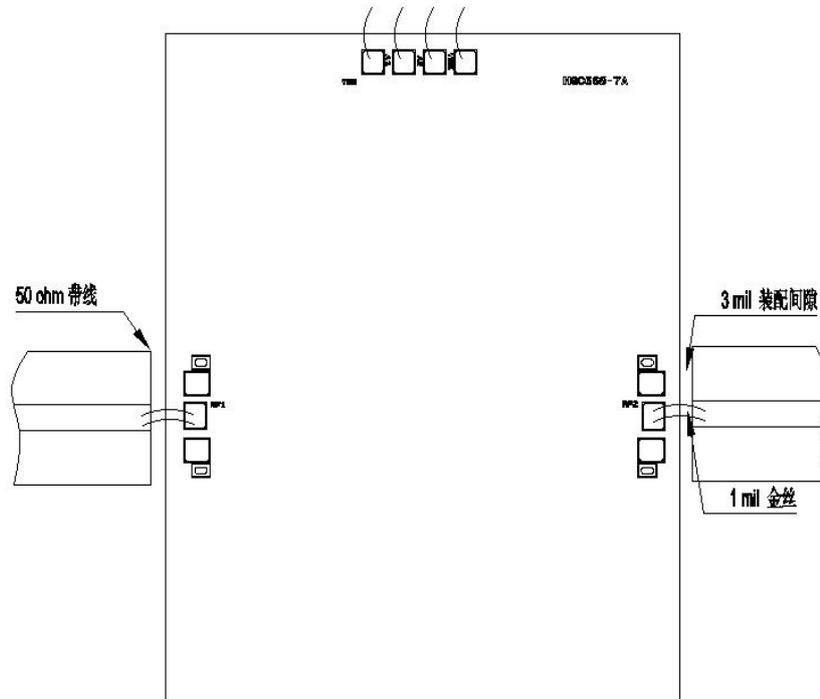
焊盘序号	功能	描述
1	RF1	该焊盘是 RF 信号输入端口, DC 耦合并匹配至 50 Ohm
6	RF2	该焊盘是 RF 信号输出端口, DC 耦合并匹配至 50 Ohm
2, 5	VEE	该焊盘是驱动电路电源端口, 使用时任选一端接-5V 电压
3-4	A1-A2	该系列焊盘是控制端口, 控制关系见真值表
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地



真值表

通道	A1	A2
9-9.6GHz	0	0
9.6-10.2GHz	0	1
10.2-10.8GHz	1	0
10.8-11.4GHz	1	1
“0” 电平范围: 0~0.8V, “1” 电平范围: 2.3~5V		

推荐装配图



注意事项

1. 本芯片属于静电敏感器件，运输、存储和使用过程中注意静电防护
2. 厚度为 100 um
3. 典型键合焊盘尺寸为 120*100 um²
4. 键合焊盘金属化：金
5. 芯片背面镀金
6. 芯片背面接地
7. 未标注的键合焊盘不需要连接
8. 钝化层信息：材质：SiN；厚度：0.6um，

极限参数

1. 电源电压：-6 V
2. 射频输入功率：+26 dBm
3. 储存温度：-65 ~ +150°C
4. 工作温度：-55 ~ +85°C